

BIOGRAPHY

SPT Tutorial 2026 1st



강동균 TL
SK hynix

약력

■ 학력

고려대학교 재료공학과 학/석/박사 졸업

■ 경력

- . 2008년 01월 ~ : 하이닉스반도체 입사
- . ~ 2009년 09월 : 연구소 선행공정 Diffusion 공정 (NAND Gate 절연막 개발)
- . ~ 2015년 11월 : 미래기술연구원 R&D공정 Thin Film 공정 (DRAM WL/BL 전극 개발)
- . ~ 2019년 04월 : DRAM 1y Tech. 제품 개발 (Thin Film 공정 리더)
- . ~ 2020년 12월 : DRAM 1a Tech. 제품 개발 (Thin Film 공정 리더)
- . ~ 2022년 12월 : 미래기술연구원 R&D공정 Thin Film 공정 (DRAM Capacitor 전극 개발)
- . ~ 2024년 12월 : SK하이닉스 SKHU Thin Film 공정 전문 강사
- . ~ 현재 : 미래기술연구원 R&D공정 Thin Film 공정 (DRAM WL 전극 개발)

■ 주요 강의 활동

- . SKHU (사내/협력업체 대상) 및 국내 대학 (학부/대학원 산학) 강의
 - : "Thin Film Process 입문/기본/심화" & "DRAM Metal 전극 (WL/BL/Capacitor) 기술 동향"
- . 산업통상자원부 & 한국반도체산업협회 주관 반도체인프라활용 현장인력양성 과정 참여
 - : "반도체 제조 8대 공정 Overview"
- . 고용노동부 & SK하이닉스 주관 청년 Hy-Po, Hy-Five 교육 프로그램 참여
 - : "Thin Film Process 입문/기본"
- . 산업통상자원부 & 한국반도체산업협회 주관 한국반도체아카데미 교육 프로그램 참여
 - : "Thin Film Process 입문/기본"
- . 반도체 hy-스쿨 (고교생 대상 반도체 입문 교육)



: “반도체 기술 및 시장 동향”, “강남인강 (영상 8편), 반도체 제조 8대 공정”

강의개요

최근 반도체 산업은 초고속, 저전력, 고집적 등 메모리 소자의 성능을 향상시키기 위한 방향으로 연구 개발을 활발하게 추진하고 있습니다. 반도체 소자를 실제로 구현하고 제품으로 만들어 내는 반도체 제조 공정은 이를 위해 새로운 기술 및 소재의 개발과 함께 기존 소자의 구조를 개선하는 등의 다양한 연구를 병행하고 있습니다.

본 강의는 Thin Film 공정의 기본 개념 및 용어와 함께 해당 공정의 증착 방법, 각 증착 물질의 특징과 장단점에 대해 이해하고 이를 바탕으로 특히, Dielectric, Metal 물질 별 응용 사례를 파악하여 Thin Film 공정에 대한 이해도를 높이는 과정입니다.